江苏微导纳米科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	■特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　■业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 ■现场参观　　■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中银基金、光大证券、富国基金、长江证券、淡水泉、国泰君安、东证资管、招商基金、民生证券、嘉实基金、财通基金、天风证券、国联证券、华宝基金、汇添富、浙商证券、建投基金、惠升基金、光大资管、东海基金、华能信托、信泰人寿、中信证券、工银安盛资管、龙赢私募、东方海峡、朱雀基金、中邮基金、懿坤基金、景泰利丰、德邦证券、保德信、广发基金、永赢基金、西部证券、申九资产、和谐汇一、中华联合、中信建投、弥远投资、圆信永丰、留仁资产、人保公募、海富通、磐厚动量、奇点投资、凯石基金、拓璞基金、慎知资产、明世伙伴基金、太平资产、正圆投资、泰信基金、平安资管、京管泰富基金、峰岚资产、易米基金、天治基金、海通自营、国泰基金、南京证券、摩根华鑫、广州云禧私募、辰翔基金、中金资管、西部证券、华安基金、中信证券资管、安信基金广深区、工银安盛资管、中欧瑞博、新华基金、汐泰投资、合众资产、景顺长城、长城财富、弘尚资产、创金合信、泰康资产、恒越基金、鑫元基金、民生加银基金、同犇投资、中欧基金、方正富邦基金、泓德基金、惠升基金、申万菱信、太保资产、兴业基金、诚盛投资、路博迈投资、深圳银德资本、东吴基金、上海金犖投资、中融鼎、华夏基金、湍团基金、睿远基金、盈峰资产、德毅资产、鹏扬基金、建信基金、大家资管、人保资产、清和泉、中邮人寿、中银资管、趣时投资、恒松资本、山楂树资产、瑰铄投资、源乘投资、南土资产、混沌投资、高毅资产上海、泰旸资产

<table>
<tr><td>公司接待人员姓名</td><td colspan="3">董事会秘书龙文、证券事务代表朱敏晓、证券部王少峰</td></tr>
<tr><td>日期/时间</td><td>2023 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日</td><td>地点</td><td>公司会议室、网络会议</td></tr>
<tr><td>投资者关系活动主要内容介绍</td><td colspan="3">主要交流问题及回复如下：

1、公司当前订单情况如何？

截止 2022 年 12 月底，公司在手专用设备订单 22.93 亿元，其中光伏设备订单 19.67 亿元，半导体设备订单 2.57 亿元，其他设备订单 6881 万元。2023 年 1 月初至 2022 年年度报告披露日，公司新增专用设备订单 22.74 亿元，其中新增半导体设备订单 2.42 亿元，新增光伏设备订单 20.16 亿元，新增其他设备订单 1580 万元。

2、公司订单开始放量的主要原因是什么？

公司订单增长放量，主要是由于公司前期产品布局逐步的落地所致。终端应用需求增长、进口替代和自主可控等因素驱动了国内晶圆厂逆周期扩产和工艺迭代升级，加速了国内半导体行业头部客户对国产 ALD 设备的产业化验证。同时在全球碳中和的背景下光伏行业快速发展，装机量持续增加，客户产能扩充计划加速。随着公司与行业多家头部客户共同合作的 TOPCon 新型高效电池生产线实现规模化的量产，TOPCon 产能率先放量，下游客户扩产计划加速。

3、公司目前在半导体各细分领域内的进展如何？

在半导体领域内，公司已与国内多家厂商建立了深度的合作关系，相关产品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新型显示等诸多细分应用领域。随着客户对公司设备的验证加速，使半导体业务的发展进一步的提速，多款产品取得了重复订单，部分产品取得了批量订单，整体业务呈现健康发展的趋势。

4、公司目前正在开发的 iTronix 系列 CVD 系统产品的竞争优势是什么？

目前国内 CVD 市场的整体国产化率还较低，国内 CVD 设备市场具有十分广阔的市场空间。iTronix 系列 CVD 系统，系公司基于客户关键工艺开发的战略需求，正在开发的新产品系列，适用于沉积氧化物、氮</td></tr>
</table>

	化物等薄膜材料。产品可用于芯片制造钝化层、扩散阻挡层、介电层、硬掩膜层与高级图案化层、电容覆盖层等应用领域。 该系列产品依托产业化应用中心强大的前瞻工艺开发能力及国际化的研发团队，以及公司所具有的半导体设备设计制造能力，解决关键工艺卡脖子问题，通过差异化策略开发 CVD 领域具有市场前景和竞争力的关键设备。 **5、公司产品的开发实现、产业化验证和产业化应用的具体划分标准是什么？** 公司产品所处阶段中，产业化应用是指已实现销售；产业化验证是指已签署合同并正在履行；开发实现是指已形成研发样机，虽未与客户签署销售合同但已发往客户处进行试样验证。 **6、公司的产能如何，将如何消化目前在手的订单？交付情况如何？** 公司通过内部管理提升、供应链管理优化、场地增加、人员招聘等方式积极提升产能，目前产能能够较好的满足订单交付需求。公司产品的交付因不同合同存在一定差异。 **7、目前公司研发投入中半导体与光伏的分配情况如何？** 2022 年公司研发投入 1.38 亿元，相较去年同期增长 42.62%，占收入比例为 20.22%。其中，半导体领域研发投入占比约为 55.19%，投向包括逻辑、存储、新型显示器、化合物半导体等项目；光伏领域研发投入占比约为 37.47%，投向包括 TOPCon 的持续提升及 XBC、钙钛矿/异质结叠层电池等下一代高效电池技术等项目。根据公司投资计划，与半导体有关的募集项目“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”和“集成电路高端装备产业化应用中心项目”的拟投资总额分别为 5 亿元和 1 亿元，合计占总体募投项目拟投资总额 10 亿元的 60%。“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”的拟投资总额为 2.5 亿元，占总体募投项目拟投资总额 25%。 **8、公司 2022 年度的利润分配方案和未来资金使用计划如何？** 主要是考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求量较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利

	益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。公司的自有资金和募集资金将用于募资项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”、“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”和“集成电路高端装备产业化应用中心项目”，同时增加研发投入加速产业化，储备资金满足当前订单所需，以及加大市场扩展力度抢占先机。 **9、公司在半导体和光伏领域的产品布局如何？** 半导体领域，公司加速逻辑、存储芯片、化合物半导体、新型显示芯片等半导体各细分领域产品的产业化，针对各细分应用领域研发试制新型 ALD 设备，并进一步完善产品矩阵，开发 CVD 等产品，满足客户在各技术节点上对薄膜沉积设备的需求。公司已开发的 ALD 设备，适用于沉积各种氧化物和氮化物、互相掺杂沉积工艺等薄膜材料，可广泛应用于逻辑芯片、传统及新型存储芯片的电容介质层、高 K 栅介质覆盖层、掺杂介质层、芯片制造电极及阻挡层、化合物半导体钝化和过渡层、MEMS 和 CMOS 芯片的多重图案化和间隔层等众多应用领域。 在光伏领域内，公司持续丰富产品线，提供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等多种产品，推进实施 AEP®（ALD Enabled Photovoltaics）技术为核心的 TOPCon 电池工艺整线策略，提高公司产品在客户产线投资中的占比，为客户提供更为完整、高效、经济的薄膜沉积解决方案。2022 年，由公司开发的行业内首条 GW 级 TOPCon 工艺整线项目已经取得客户的验收，实现产业化应用，并快速放量逐步成为行业主流电池技术。同期，公司已经出货了 XBC、钙钛矿/异质结叠层电池等新一代高效电池技术相关产品，未来将进一步持续进行研发和投入，迭代发展升级，从而引领相关技术的产业化。 **10、公司的未来发展战略是什么？** 未来，公司坚持以原子层沉积（ALD）技术为核心，并拓展多种 CVD 等真空薄膜技术及产品开发，依托于产业化应用中心，引领创新性应用，不断向各领域进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开发半导体、下一代光伏电池、柔性电子等领域具有市场竞争力的产品。通过为客户提供一流技术、一流品质和一流服务，不断扩展市场占有率，打造高端

	装备制造商的优质品牌，实现高端技术装备的国产化、产业化，择机通过收购等方式，对核心技术上下游关键工艺进行技术整合，针对新兴产业形成一整套技术解决方案，力争成为全球微纳制造装备领导者。
风险提示	1、以上如涉及对行业的预测、公司发展战略等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2、电话会议参会名单由会议组织方提供。